

Diagram illustrating the geometry of a TSV (Through-Silicon Via) structure. The structure is shown in cross-section, with a central vertical stem and two side walls. The top surface is labeled "TSV". The side walls are labeled "1:3". The central stem is labeled "0.03Q". The width of the side walls is indicated as 1.75 m on each side.



 J•ENSUU		KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIikka				
12. Utra Nousianpuiston pyörätiet JKPP 0 Katusuunnitelma Pituusleikkaus, typpipoikkileikkaus	Päiväys		Mittakaavat			
	28.11.2025		1:1000/1:100, 1:100			
	Suunnittelija		Kadunpito päätös			
	Destia Oy					
	Hyväksyjät		Päätökset			
Koordinaattijärjestelmät: ETRS-GK30 ja N2000		K	509522	15	24	
		Suunn.ala	Piir.n:o	Osa n:o	Vuosi	M
 A COLAS COMPANY		Suunnittelija <i>Saku Heiskanen</i>				
DESTIA OY, Infra suunnittelu Ohjelmakaari 10 40500 JYVÄSKYLÄ 020 444 11 (vaihde) etunimi.sukunimi@destia.fi		Projektipäällikkö <i>Juha Antila</i>				